

05.2;06.1;06.2;11;12

**ВРЕМЕННОЙ ДРЕЙФ ПАРАМЕТРОВ  
ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА ФОСФИД ИНДИЯ—  
ДВУОКИСЬ КРЕМНИЯ**

© Л. С. Берман, А. Д. Габараева, А. В. Каманин, И. Каримов,  
Л. Е. Клячкин, Л. В. Шаронова, Н. М. Шмидт

Временной дрейф параметров границы раздела соединения  $A^3B^5$  — диэлектрик, и в частности  $InP-SiO_2$ , — одна из основных проблем физики границы раздела. Несмотря на достигнутые в последнее десятиление успехи в понимании физической природы временного дрейфа [1–7], временной интервал, соответствующий сравнительно слабым изменениям параметров границы, не превышает нескольких часов [6,7].

Поэтому целесообразно, наряду с ранее установленными причинами [1–4], проанализировать практически не рассматривавшиеся, связанные с объемными свойствами диэлектрика. Опыт кремниевой технологии [8] позволяет предположить, что низкотемпературные методы, используемые обычно для нанесения диэлектрика в технологии  $A^3B^5$ , не обеспечивают полную релаксацию неравновесных дефектов, вводимых при формировании диэлектрика. Это приводит к структурным нарушениям не только в приповерхностной области полупроводника, но и в объеме диэлектрика. Эти структурные нарушения выражаются в образовании неустойчивых, деформированных Si-O связей в кремний-кислородных тетраэдрах. Эти особенности и могут быть ответственны за временной дрейф параметров границы полупроводник–низкотемпературный  $SiO_2$ .

Целью нашей работы было выяснение влияния особенностей объемных свойств диэлектрика, возникающих при низкотемпературных неравновесных условиях его получения, на параметры границы раздела  $InP$  — диэлектрик их временной дрейф.

В качестве диэлектрика был выбран  $SiO_2$ , так как его структурные особенности изучены гораздо лучше, чем других диэлектриков, и в то же время эти особенности являются типичными, например для собственных оксидов  $A^3B^5$  типа  $ABO$  [9]. Поэтому рост  $SiO_2$  и исследование параметров границы раздела  $SiO_2$ –полупроводник осуществлялись как на  $InP$ , так и на кремнии.

Методика эксперимента. Пленки  $\text{SiO}_2$  выращивались на подложках  $n\text{-InP}$  и  $n\text{-Si}$  методом химического осаждения из паровой фазы (CVD) [10] в одном процессе при температуре  $350^\circ\text{C}$ . Химическая подготовка подложек проводилась по стандартным методикам.

На полученных образцах определялся показатель преломления на эллипсометре ЛЭФ-3М на длине волны  $0.632 \text{ мкм}$ . Для исследования структуры пленок  $\text{SiO}_2$  был использован метод инфракрасной спектроскопии. Инфракрасные спектры поглощения записывались на спектрофотометре SPECORD IR75 в диапазоне  $500\text{--}1400 \text{ см}^{-1}$ . Электрические параметры границы раздела исследовались на МДП структурах:  $\text{Al-SiO}_2$  —  $n\text{-InPm}$  и  $\text{Al-SiO}_2$  —  $n\text{-Si}$ . Частотная зависимость емкости  $\text{SiO}_2$  определялась на мосте SWM3-2 в диапазоне частот  $1 \text{ кГц}\text{--}1 \text{ МГц}$ . Вольтфарадные характеристики (ВФХ) и изотермическая релаксация емкости  $C(t)$  измерялись на автоматизированной установке [11] на частоте  $100 \text{ кГц}$ .

Временной дрейф параметров границы раздела оценивался по изотермической релаксации емкости после переключения от обогащения к обеднению (после длительной выдержки при обогащении). Зависимость  $C(t)$  измерялась в интервале  $0.1\text{--}1.3 \cdot 10^3 \text{ с}$ , и в этом временном интервале временной дрейф определялся как  $|\Delta C/C| \%$ . Следует отметить, что общепринятой методики определения временной нестабильности в настоящее время нет. Использованная нами методика позволяет проследить за теми же процессами, которые ответственны за дрейф тока в полевых транзисторах и сдвиг потенциала плоских зон во времени, и допускает количественное сравнение результатов измерений.

Проведенные исследования показали, что слои  $\text{SiO}_2$ , выращенные на подложках InP и Si в одном процессе, практически не отличаются по объемным свойствам диэлектрика: показателю преломления ( $n$ ), диэлектрической проницаемости ( $\epsilon$ ), толщине ( $d$ ), скорости травления ( $v_{\text{et}}$ ). Типичным являются близкие значения фиксированного заряда  $Q_0/q : 8 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-2}$  для  $\text{Si-SiO}_2$  и  $5 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-2}$  для  $\text{InP-SiO}_2$ . При этом значение  $|\Delta C/C| \%$  составляет 6% как для той, так и для другой границы. Таким образом, временной дрейф близок к обычно наблюдаемому на  $\text{A}^3\text{B}^5$ .

$C-V$  характеристики МДП структур не вполне идентичны: например, для  $\text{InP-SiO}_2$  типичным является гистерезис, достигающий для некоторых образцов значений  $\sim 1 \text{ В}$ ; для  $\text{Si-SiO}_2$  он, как правило, незначителен (рис. 1). В то же время для структур  $\text{Si-SiO}_2$  характерным является аномальное поведение емкости: ее уменьшение после переключения структуры от "+" к "-". Однако в данной работе мы не бу-

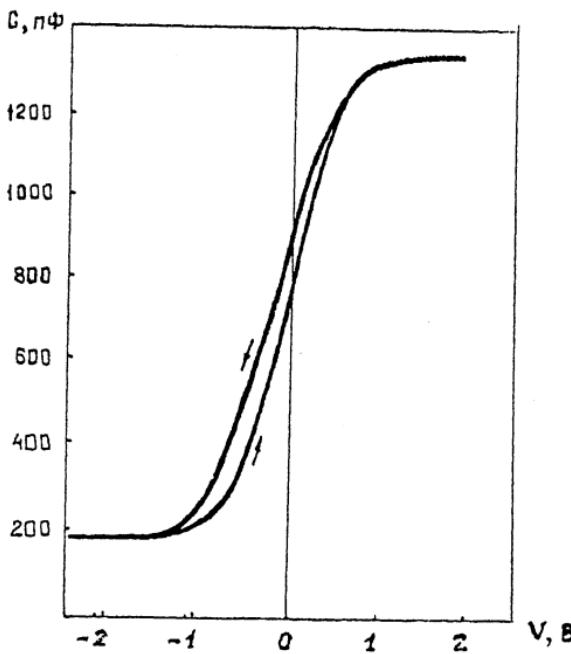


Рис. 1. Вольт-фарадная характеристика структуры Si-SiO<sub>2</sub>. Режим измерения при  $T = 293$  К: выдержка 24 ч при  $U = 0$  В; переключение от 2.2 до -4.6 В и обратно;  $dV/dt = 33$  мВ/с.

дем обсуждать эти особенности. Для образцов InP-SiO<sub>2</sub> методом изотермической релаксации емкости был определен энергетический спектр плотности состояний. В минимуме  $N_{t\min} = (5 \pm 1) \cdot 10^{11}$  эВ<sup>-1</sup> · см<sup>-2</sup>.

Сравнение свойств полученного SiO<sub>2</sub> с термическим показало, что  $n$  у них совпадает с большой точностью (1.456), значение  $\epsilon$  для низкотемпературного SiO<sub>2</sub> равно 5.2, что несколько выше, чем у термического SiO<sub>2</sub>. Частотная зависимость емкости для низкотемпературного SiO<sub>2</sub>, так же как для термического, отсутствует. Скорость травления в несколько раз выше (180 Å/мин), чем для термических окислов (30 Å/мин [12]), что свидетельствует о структурных изменениях в объеме SiO<sub>2</sub>. Эти изменения подтверждаются исследованием спектров поглощения. Основной пик, связанный с поглощением на колебаниях Si-O связей (рис. 2), смешен относительно положения этого пика для термического окисла ( $1100$  см<sup>-1</sup>), причем для структур InP-SiO<sub>2</sub> это смещение, как правило, несколько больше. Наблюдаемый сдвиг достаточно типичен для низкотемпературного SiO<sub>2</sub> и наблюдается для структур Si-SiO<sub>2</sub> разными авторами [13]. Этот сдвиг свидетельствует о структурных изменениях в SiO<sub>2</sub>, связанных с деформацией Si-O связей. Присутствие вторых максимумов в диапазоне  $810$ - $820$  см<sup>-1</sup> связано с разорванными Si-O связями.

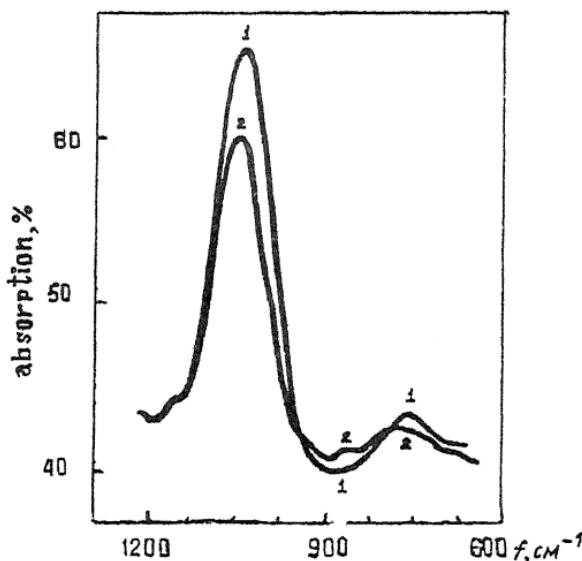


Рис. 2. Инфракрасные спектры поглощения  $\text{SiO}_2$ : 1 —  $\text{InP}-\text{SiO}_2$ ; 2 —  $\text{Si}-\text{SiO}_2$ .

Теоретический и экспериментальный опыт исследования динамических свойств  $\text{Si}-\text{O}-\text{Si}$  связей и  $\text{Si}-\text{O}$  связей в тетраэдре  $\text{SiO}_4$  [14] позволяет говорить о том, что деформация  $\text{Si}-\text{O}$  связей может приводить к изменению зарядового состояния тетраэдра и его поляризации. Причем заряд не локализован внутри тетраэдра и может распространяться на ближайшие катионы, вызывая изменение полного заряда соседнего тетраэдра. Это изменение может вызывать изменение длин связей  $\text{Si}-\text{O}$  в соседнем тетраэдре. Эти динамические свойства  $\text{Si}-\text{O}$  связей и  $\text{SiO}_4$  тетраэдров и могут быть ключом к пониманию временных нестабильностей  $\text{InP}-\text{SiO}_2$ ;  $\text{Si}-\text{SiO}_2$  структур при полевых воздействиях.

Полученные результаты свидетельствуют о связи временного дрейфа со структурными особенностями  $\text{SiO}_2$ , полученного низкотемпературными методами.

Работа выполнена при поддержке Международного научного фонда (грант № NU 2000).

#### Список литературы

- [1] Lile D.L., Taylor M.J., // J. Appl. Phys. 1983. V. 54. N 1. P. 260–267.
- [2] Tardy J., Thomas I., Viktorovich P. et al. // Appl. Surf. Sci. 1991. V. 50. P. 383–389.
- [3] Hollinger G., Bergignat E., Joseph J., Robach Y. // J. Vac. Sci. Technol. 1985. V. A3. N 6. P. 2082–2088.
- [4] Juang M.T., Wager J.F., Van Vechten J.A. // J. Electrochem. Soc. 1988. V. 135. N 8. P. 2019–2023.

- [5] Hasegawa H., Ohno H. // J. Vac. Sci. Technol. 1986. V. B4. N 4. P. 1130-1138.
- [6] Akazawa M., Hasegawa H., Ohue E., // Jpn. J. Appl. Phys. 1989. V. 28. N 11. P. L2095-L2097.
- [7] Kodama S., Koyanagi S., Hashizume T., Hasegawa H. // Jpn. J. Appl. Phys. 1995. V. 34. N 2B. P. 1143-1148.
- [8] Башкин М.О., Емельянов А.В., Портнов С.М., Самсонов Н.С. // Электронная промышленность. 1992. № 1. С. 2-5.
- [9] Pantelidis S.T. // J. Vac. Sci. Technol. 1977. V. 14. N 4. P. 965-967.
- [10] Современные проблемы физической химии поверхности полупроводников. 1988. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние. 238 с.
- [11] Берман Л.С. Универсальная измерительная установка для емкостной спектроскопии полупроводников. Препринт ФТИ, № 974, 1985. 25 с.
- [12] Барабан А.П., Булавин В.В., Коноров П.П. Электронника слоев SiO<sub>2</sub> на кремнии. Л.: Изд.-во ЛГУ, 1988. 303 с.
- [13] Раков А.В. Спектрофотометрия тонкопленочных полупроводниковых структур. М.: Радио и связь, 1975. 250 с.
- [14] Квантовая химия молекулярных систем и кристаллохимия силикатов. Л.: Наука, 1988. 72 с.

Поступило в Редакцию  
16 ноября 1995 г.

---